

innodisk

# 宜鼎國際 (代號:5289) 業績說明會

董事長 簡川勝 2025.11.24

## 免責說明

本簡報及同時發佈之財務業務訊息及預測性資訊，乃是建立在本公司從內部及外部來源所取得之資訊基礎。本公司未來實際所發生之營運結果及財務狀況可能與這些明示或暗示之預測性資訊有所差異，其原因可能來自於本公司無法掌握之各種風險因素。

本簡報中對未來的展望反映本公司截至目前為止對於未來的看法，對於這些看法，未來若有任何變動或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。

# 議程

- 公司簡介與概況
- 市場趨勢與產品策略
- 全球 AI IN ACTION 商務拓展
- ESG 永續承諾
- 財務資訊
- 提問與說明

# 公司簡介與概況

成立

# 2005 年

2025 年為 Innodisk 宜鼎國際  
成立 20 週年

**營業額**

**NTD 94.5 億元**  
(2025Q3)

**資本額**

**NTD 9.53 億元**

**EPS**

**NTD 12.46 元**  
(2025Q3)

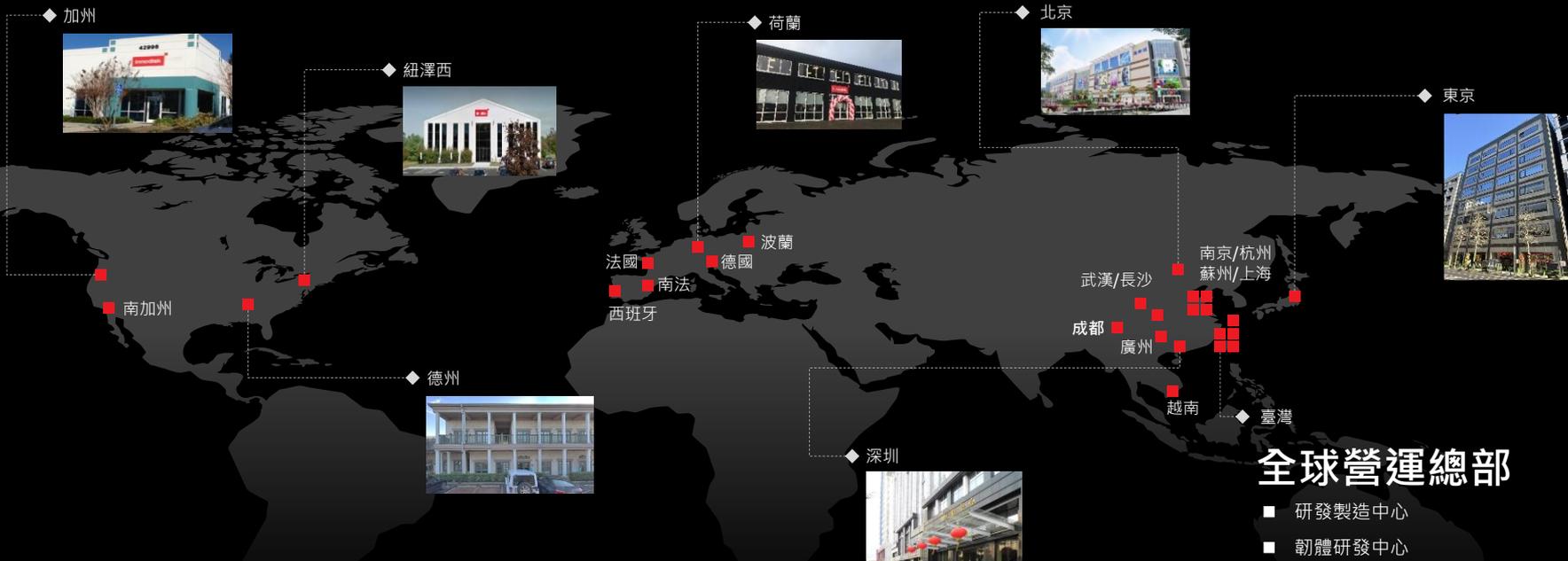
**專利數**

**197個 (+5個)**

**客戶數**

**4,000+**

# 全球營運佈局



## 全球營運總部

- 研發製造中心
- 韌體研發中心



營業地區

25

全球員工

1,139

台灣：998 / 海外：141

基地面積 (平方米)

**27,000**

建築面積：一廠 (平方米)

**12,000**

2025 產能 (SMT x 6)

**900K**

最大產能 (SMT x 8)

**1,200K**

建築面積：二廠 (平方米)

**15,000**

▶ Edge AI 系統與解決方案  
Edge AI 嵌入式周邊模組  
Edge AI 嵌入式相機模組



**宜蘭研發製造中心**

廠辦空間

合計 5,900 坪

17F 500 坪 (安提)

16F 1,000 坪

7F 1,000 坪 (安提 200 坪)

5F 1,000 坪

4F 1,000 坪

3F 1,000 坪

2F 400 坪 (安提 200 坪)

汐止全球營運總部



產能

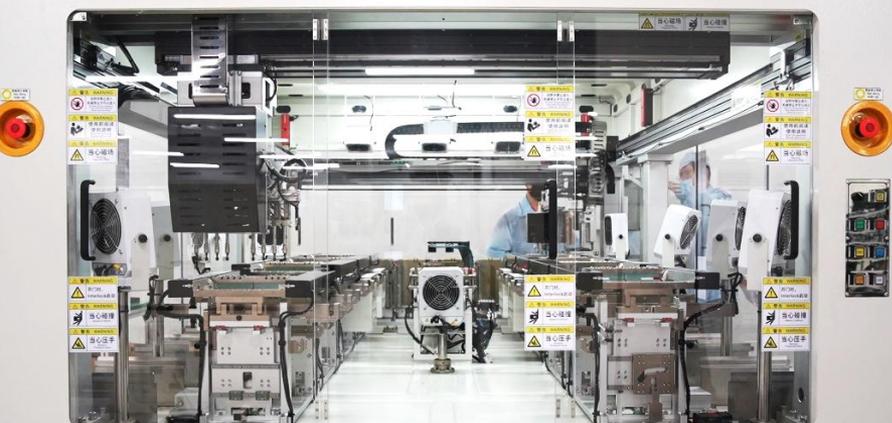
1,350K / Monthly ( 2025 )

認證

ISO9001 / ISO14001 / ISO45001 / QC080000 /  
ISO14064-1 / ISO27001

廠區

新北市 / 宜蘭縣



核心生產製造理念：品質、永續

## 強化零信任基礎網路資安架構韌性

- 因應地緣政治衝擊與強化公司資訊韌性，打造雲地整合的應用架構
- 佈署資安防護區塊依營運需求層層保護：研發端、製造端、後勤端
- 完善洩止及宜蘭資訊服務維運支援中心
- 精實資訊服務作業方法（權限、資料治理、處置時效）及落實教育訓練、強化同仁資訊與 AI 素養

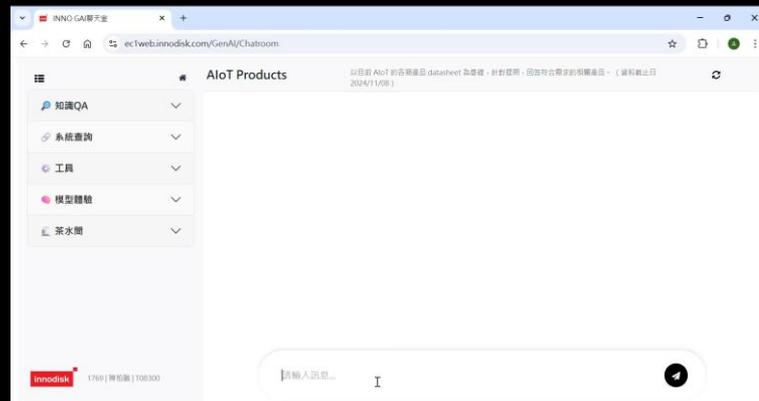
## 健全資通訊安全治理

- 在第三方的驗證下都保持在 **A 等級** 的水準
- 在「永續發展暨資安委員會」下統合推動公司 ESG 永續策略，強化資訊安全管理機制，完善整體永續治理
- 已取得 ISO27001:2022 版認證並加入 TWCERT/CC、物聯網產業協會等資安聯盟，協同資安的加強保護



## GAI 落地應用與智能整合

- 在資訊安全風險可控下，持續運用 GAI 智能化創新
- 普及運用 GAI 技術於實作場域以達成智能化/效率化的專業高效落地
- 搭配多元第三方技術資源深化公司在 GAI/ML/RPA 智能整合應用深度
- 持續 ESG 永續 IT 的項目：
  - IT 採購硬體裝置與資料佈署以實踐永續 IT 目標
  - 調適雲端應用以對耗能碳排效益最大化



# 強化資安架構韌性

打造多層次零信任架構 健全資安治理 建構 GAI 智能整合創新

## 全球夥伴與市場認可

## 合作夥伴

intel

Intel 官方合作夥伴  
Gold Partner

nvidia

NVIDIA Elite Partner (安提)  
MGX Partner (安提)

Qualcomm

Qualcomm IoT  
官方合作夥伴

Microsoft

Azure Sphere  
官方合作夥伴

 AXELERA  
NXP  
MEDIATEK Rockchip AI ASIC
AI ASIC & NPU  
合作夥伴

## 經營成果

Gartner

全球工業級固態硬碟  
市佔第一

TRENDFORCE

全球前十大  
DRAM 模組供應商

Interbrand

台灣國際品牌  
TOP 40

Forbes

前 200 大  
亞洲中小型企業

## 產品創新


 TAIWAN  
EXCELLENCE

2025 ~ 2026 E3.L PCIe Gen5 資料中心固態硬碟  
 2025 ~ 2026 LPDDR5X LPCAMM2 記憶體模組  
 2025 ~ 2026 MIPI over Type-C 8MP 定焦相機模組  
 2025 ~ 2026 邊緣 AI 系統 (APEX-P200)  
 2025 ~ 2026 AI 代理人邊緣運算工作站 (AIP-FR68S)  
 2025 ~ 2026 多加速卡邊緣 AI 推論系統 (AIP-MURE)


 BEST IN SHOW  
Embedded  
WINNER

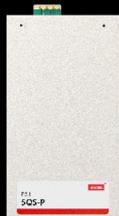
2025 MIPI over Type-C 相機模組  
 2025 E3.L 5QS-P 資料中心固態硬碟  
 2024 E1.S 4TG2-P 固態硬碟  
 2023 nanoSSD 微型固態硬碟


 MOST INNOVATIVE  
MEMORY TECHNOLOGY  
AWARDS  
Embedded  
MEMORY TECHNOLOGY

2025 CXL 記憶體模組  
 2022 極寬溫 DDR4 記憶體模組


 BEST IN SHOW  
AWARDS  
Embedded  
MEMORY TECHNOLOGY

2024 USB 嵌入式相機模組



**E3.L PCIe Gen5**  
資料中心固態硬碟



**LPDDR5X LPCAMM2**  
記憶體模組



**MIPI over Type-C**  
8MP 定焦相機模組



**邊緣 AI 系統**  
APEX-P200



aetina

**AI 代理人邊緣運算工作站**  
AIP-FR68S



aetina

**多加速卡邊緣 AI 推論系統**  
AIP-MURE

# 市場趨勢與產品策略

工業電腦市場

IIoT 垂直市場

AIoT 垂直市場

邊緣 AI 應用市場



智慧能源

零售與物流

交通運輸

企業

醫療

航太

邊緣伺服器

通訊

製造

IT 服務

安防監控

娛樂

產業與垂直市場 AI 應用



企業 AI 應用



# AI 從雲端下放邊緣

聚焦 產業 + 企業 雙核心應用領域

Gemini deepseek meta-llama

雲端 AI

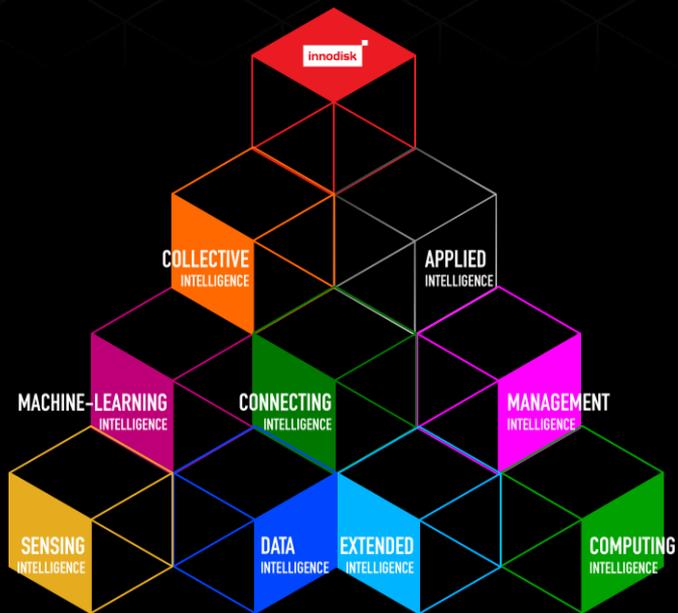
INDUSTRY EDGE AI  
產業型邊緣 AI

ENTERPRISE EDGE AI  
企業型邊緣 AI



# 邊緣 AI 智能板塊 (INTELLIGENCE BUILDING BLOCKS)

集團旗下全方位邊緣 AI 產品與解決方案



**ARCHITECT INTELLIGENCE**

軟體/韌體	雲端 AI 平台			
	AI Stack SDK			
	軟體工具			
	作業系統			
AI 加速卡	NVIDIA		Qualcomm	
	Intel		AI ASIC	
AI 平台架構	x86			
	Arm			
嵌入式周邊	Flash	Display 顯示	LAN	GNSS
	DRAM 記憶體	Storage	CANbus / CANFD	Wireless
感測器	嵌入式相機模組			
	空氣感測器			



## SENSING INTELLIGENCE

### 相機模組 | 新產品亮點



GMSL  
相機模組



MIPI over Type C  
相機延長解決方案

## PRODUCT FEATURE

- 多樣態安裝、鎖附設計，提升車機載具導入便利性
- IP67 防水防塵、IK10 衝擊防護
- 採用 ADI MAXIM GMSL SerDes 技術，工作距離達 15 米
- 提供高頻寬、低延遲、無損影像，適合 AI 邊緣運算
- 自帶相機主控晶片 ISP，掌握影像品質
- 相機驅動支援 NVIDIA Jetson / Raspberry Pi 最新平台



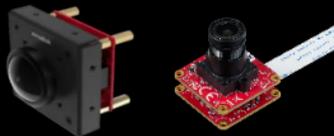
- 榮獲台灣精品獎肯定
- 可搭配強固機構，增加模組安裝與應用性
- 導入 MIPI 高速訊號延展技術
- 提供高頻寬、低延遲、無損影像，適合 AI 邊緣運算
- 自帶相機主控晶片 ISP，掌握影像品質
- 低照、寬動態適合嵌入式視覺應用情境
- 相機驅動支援 NVIDIA Jetson / Intel / Raspberry Pi 最新平台



# SENSING INTELLIGENCE

相機模組

完整驅動程式支援



MIPI CSI-2 系列相機模組



MIPI over Type-C 系列相機模組

## NVIDIA



Jetson  
AGX Orin



Jetson  
Orin NX / SUPER



Jetson  
Orin Nano / SUPER

## Intel



Intel® Core™  
Ultra processor



Raptor Lake  
13<sup>th</sup> Gen



Alder Lake  
12<sup>th</sup> Gen

## RPi



Raspberry  
Pi 5



## DATA INTELLIGENCE

### 記憶體模組 | 新產品亮點



#### DDR5 7200MT/s

邊緣 AI 超高速運算引擎

#### 規格優勢

領先全球 首發 DDR5 7200MT/s RDIMM 規格，專為 **AI 與邊緣應用** 打造，滿足超高速和低延遲的嚴苛要求。

#### 市場展望

鑑於當前 DDR4 逐步減產，客戶正加速轉向 DDR5，藉由此產品搶先導入高階運算、邊緣交換器等應用。



#### CXLE AIC (ADD-IN-CARD)

打破邊緣運算的記憶體限制

#### 規格優勢

改善市場既有方案限制，以**最高的靈活性擴增容量**，有效解決邊緣運算記憶體不足問題，大幅提升整體運算效能，並兼具成本效益。

#### 市場展望

專注 **邊緣 AI 等高階市場**，藉由 CXLE AIC 與 RDIMM 的整合，創造偕同效應。



## DATA INTELLIGENCE

### 固態硬碟 | 新產品亮點



#### ON-DEVICE SSD

Edge AI 邊緣單設備



#### ON-PREM SSD

Enterprise AI 本地伺服器

## PRODUCT FEATURE

- 低延遲、高耐用性、即時數據採集，絕佳邊緣 AI 應用存儲解決方案
  - 高容量：16TB (U.2) / 8TB (E1.S)
  - 最佳化散熱管理
  - 裝置級儲存資料加密
- 
- 高耐用（讀取密集/寫入密集）、高可靠性、最佳化散熱管理
  - 超高容量存儲：PCIe Gen5 128TB (QLC) and 32TB (eTLC)
  - 超高效能：14,000/1,0000 MB/s
  - 系統級資料加密保護



## CONNECTING INTELLIGENCE

### CAN BUS | 新產品亮點



#### EGUC-F1S3

- M.2 2242 to Single Isolated CAN FD
- Input I/F: USB 2.0 Highspeed
- Output I/F: CAN FD
- Wide Temp: -40°C ~ 85°C



#### EGUC-F2S3

- M.2 2280 to Dual Isolated CAN FD
- Input I/F: USB 2.0 Highspeed
- Output I/F: CAN FD
- Wide Temp: -40°C ~ 85°C

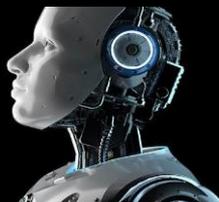


#### ESPC-F4S3

- PCIe to dual isolated CAN FD
- Input I/F: PCI Express 2.0 x1
- Output I/F: CAN FD
- Wide Temp: -40°C ~ 85°C

### 智慧連結，啟動多元應用

廣泛應用於機器人、礦業、AGV/AMR 與工業自動化等領域，提供高穩定且高效能的資料通訊。



人型機器人



礦業



AGV/AMR



工業自動化



## CONNECTING INTELLIGENCE SFP NETWORKING | 新產品亮點



### EGPL-G1F1

- M.2 to Single GbE SFP Network Module
- Input I/F: PCI Express 2 x2
- Output I/F: SFP x1
- Wide Temp: -40°C ~ 85°C



### EGPL-G2F1

- M.2 to Dual GbE SFP Network Module
- Input I/F: PCI Express 2 x2
- Output I/F: SFP x 2
- Wide Temp: -40°C ~ 85°C

## 光纖精準連結，驅動智慧產業

採用 Intel i210-IS 的 M.2 to SFP 光纖模組，支援多模與單模光纖，適用於智慧製造、監控及 AI 平台等需要穩定且高效能網路的應用。



邊緣 AI 平台

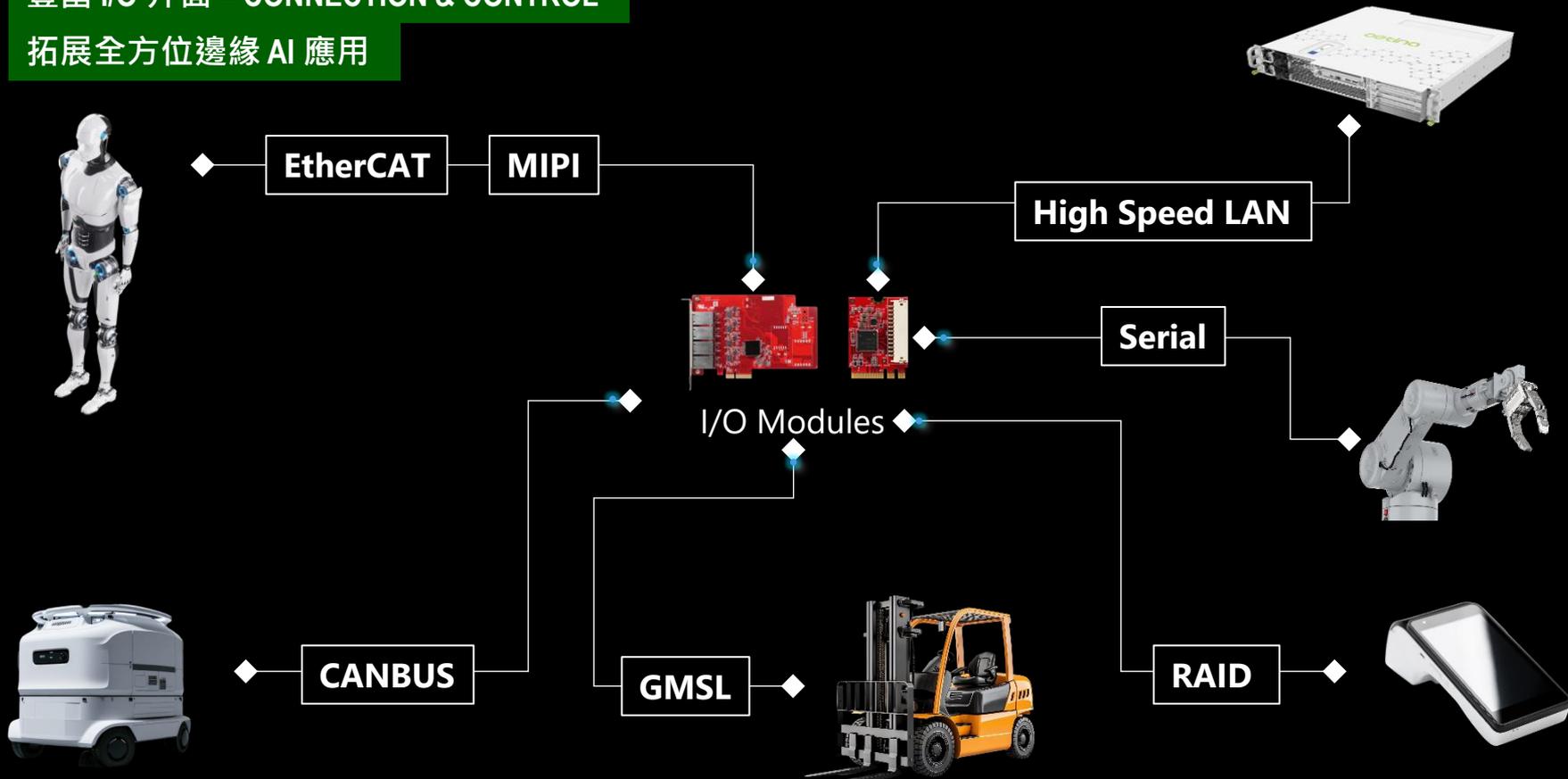
安防監控

數位看板

工業自動化

# 豐富 I/O 介面 - CONNECTION & CONTROL

## 拓展全方位邊緣 AI 應用





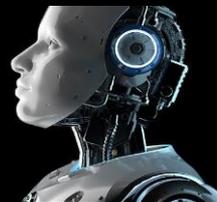
## COMPUTING INTELLIGENCE

### 新產品亮點



## AIB-THOR-ES JETSON THOR T5000™ PREVIEW KITS

### 接軌尖端機器人科技



#### Powerful AI Inference Processor

- CPU - 14 Cores ARM Poseidon-AE
- GPU – Blackwell Arch, 2560 CUDA Cores and 96 Fifth Generation Tensor Cores
- 2100 FP4 TFLOPS

#### Out-of-Box Performance

- 1 x QSFP28 up to 100GbE
- 1 x 5 GbE RJ45 Connector
- High DRAM BW – 256 bit LPDDR5X (up to 128GB Capacity)
- Audio DSP – 2 x Tensilica HiFi5 cores 16GMAC/sec

#### Variety IO Support

- 2 x USB (Type-A & C)
- 26-pin CAN header,
- HDMI 2.0/DP 1.4a

#### Comprehensive Expansion

- 2 x M.2 Key M with 1TB NVMe storage
- 1 x M.2 Key E with Wifi Module



## COMPUTING INTELLIGENCE

### 新產品亮點



#### EXMP-Q911

搭載 Qualcomm IQ-9075 COM-HPC Mini 邊緣 AI 模組



#### EXMA-Q911

搭載 Qualcomm IQ-9075M 邊緣 AI 模組

攜手打造 Qualcomm 邊緣 AI 生態系  
以高效能、低功耗驅動邊緣應用



#### AGV/AMR

機器視覺

支援 MIPI / GMSL 相機驅動整合



#### 雲端裝置管理

軟體支援

Linux/Ubuntu/BSP/SDK



#### AI 智慧監控

AI 模型支援

LLM / VLM / YoLo



#### 客製彈性

豐富的周邊設備

工業級 SSD、EP 卡

首款搭載高通 SoC 的 COM-HPC Mini Type 模組，其 Qualcomm IQ-9075 處理器，具備高達 **100 TOPS** 的 AI 性能，最高僅 **30瓦** 低功耗。

同時結合宜鼎旗下 GMSL、MIPI 相機模組、CAN 及 Serial 擴充卡，可整合應用於邊緣 AI 影像辨識及 VLM 視覺語言模型等應用領域。



# APPLIED INTELLIGENCE EDGE AI SYSTEM | APEX SERIES

Powered by



APEX-S100



APEX-X100



APEX-X200



APEX-P100



APEX-X100-Q



APEX-P200



APEX-A100



APEX-E100

10,000 TOPS

1,000 TOPS

100 TOPS

## Advanced AI inference & model training

RAG and fine-tuning AI server for LLM/SLM/VLM

## High-precision data analysis & large-scale AI inference

Advanced defect analytics, high-precision medical imaging

## Mid-to-high performance image & speech analysis

ADAS, defect detection, medical imaging assistance

## Low-power edge inference

Facial, object, and license-plate recognition

(TOPS @ INT8)

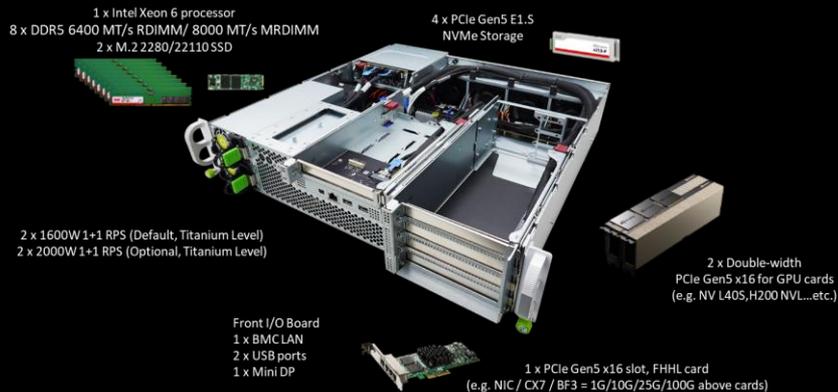


## APPLIED INTELLIGENCE EDGE AI SYSTEM | 新產品亮點



**APEX-S100 邊緣 AI 伺服器**  
ON-PREMISES LLM

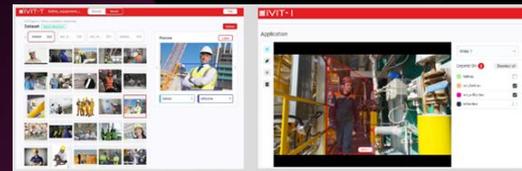
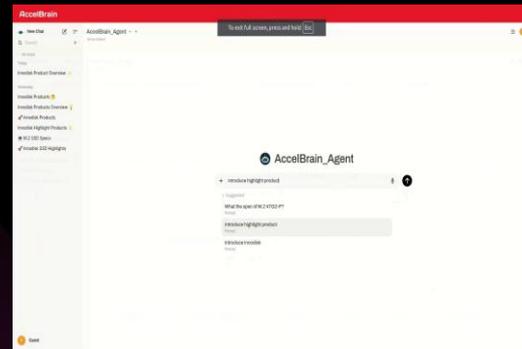
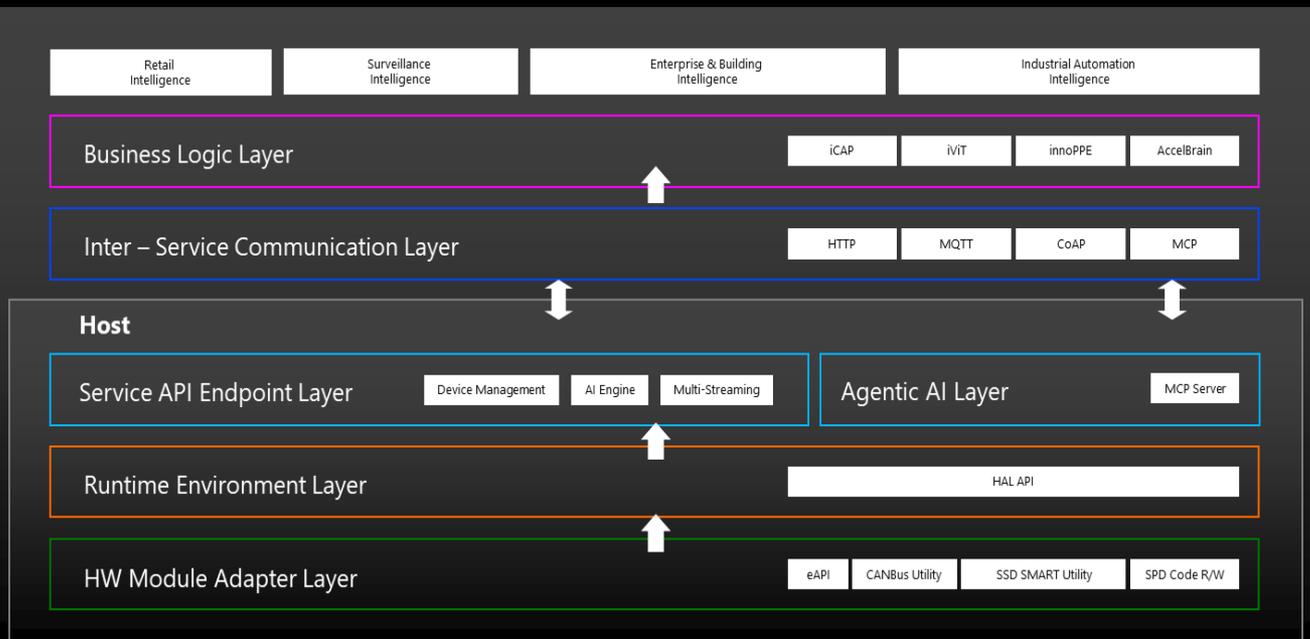
### 集團方案高度整合，賦能企業型邊緣 AI



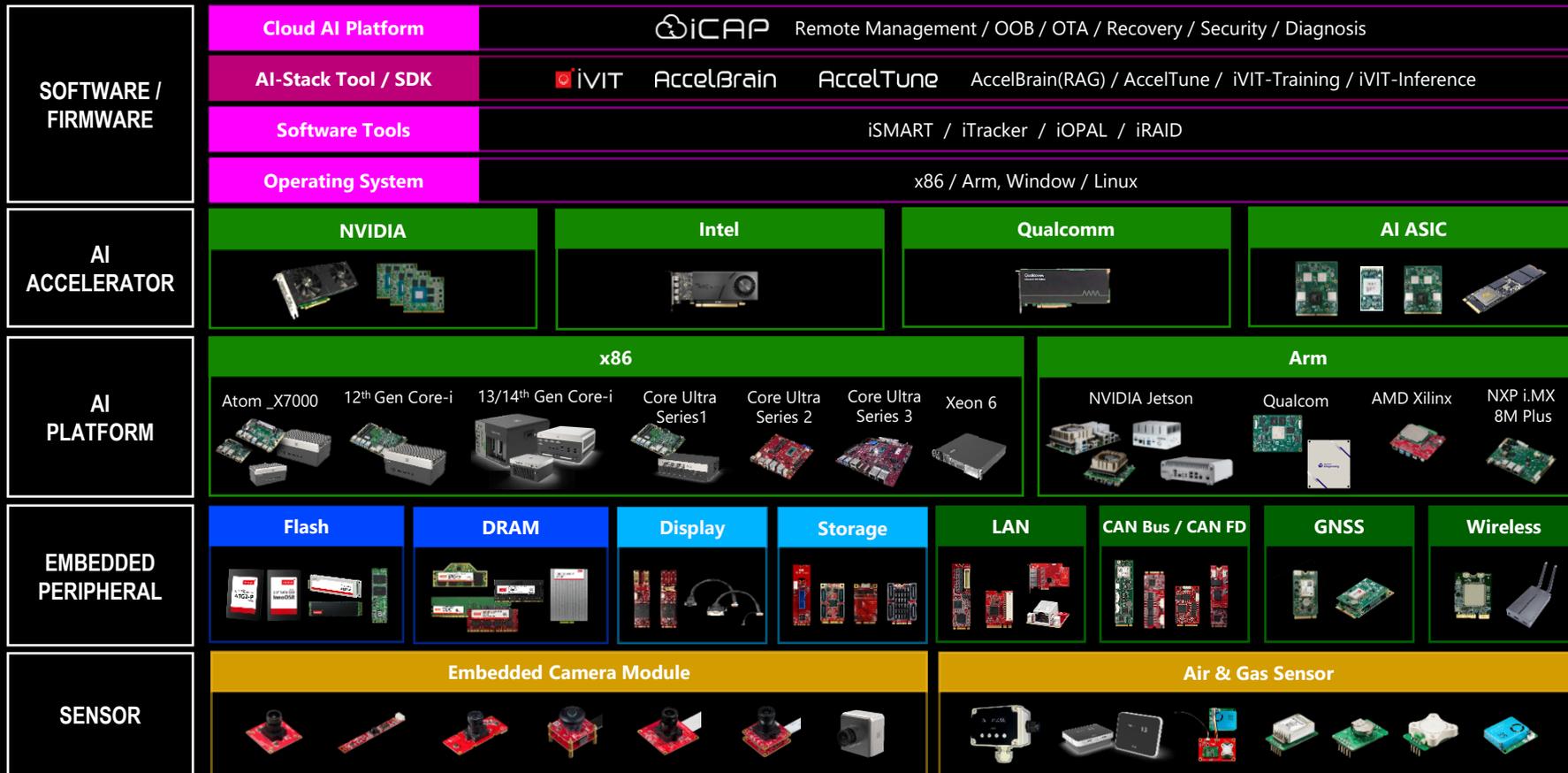
- Single Intel® Xeon® 6700-series with P-cores.
- 2U server - 420mm (16.5") short-depth rackmount server.
- 2x PCIe Gen5 x16 slots (FHFL) and 1x PCIe Gen5 x8 slot (FHFL) – supporting up to 2 double-width PCIe GPUs.
- 1x PCIe Gen5 x16 slot (FHHL) - supporting NVIDIA BlueField-3 or NVIDIA ConnectX-7

# MANAGEMENT INTELLIGENCE      MACHINE-LEARNING INTELLIGENCE

堅強軟體研發實力，創造邊緣 AI 附加價值



# INNODISK 邊緣 AI 解決方案架構 / INNODISK EDGE AI BUILDING BLOCKS



# 全球 AI IN ACTION 商務拓展

# 邊緣跨域 智慧革新 研討會

@台灣 台北

- 活動日期：2025/10/22
- 活動參與：**1,200** (線上及線下)

innodisk

aetino

AXELERA  
ARTIFICIAL INTELLIGENCE

鼎新數智

intel.

KENMEC 康邁  
ULTRASONIC TECHNOLOGY

nvidia.

Qualcomm



# 邊緣跨域 智慧革新 研討會

@台灣 台北

- 活動日期：2025/10/22
- 活動參與：**1,200** (線上及線下)

innodisk

aetina

AXELERA  
ARTIFICIAL INTELLIGENCE

鼎新數智

intel.

KENMEC  
ULTRASONIC TECHNOLOGY

nvidia.

Qualcomm



# 2025 COMPUTEX

@台灣 台北



# FMS 2025

@美國 加州



FMS25 - Taking on the FUTURE of Memory and Storage!



2025 BEST OF SHOW AWARD WINNER - INNODISK CXL MEMORY MODULE



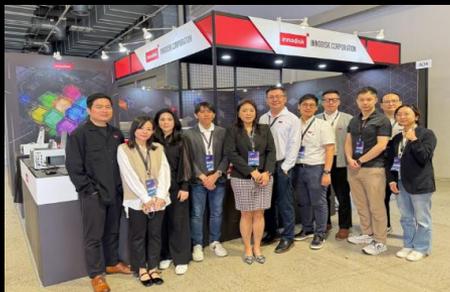
# AI INFRA SUMMIT 2025

@美國 加州



# INNODISK AI IN ACTION

於全球積極拓展邊緣 AI 解決方案



AI EXPO @台灣



OTC @美國



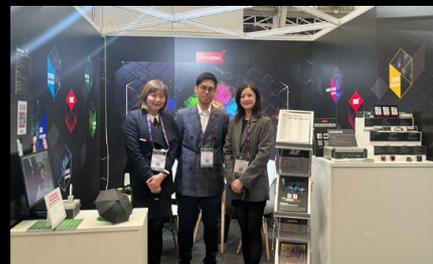
Automate @美國



SPS @義大利



Poland Seminar @波蘭



HPM @英國



Vision & Robotics @荷蘭



SIDO @法國

# ESG 永續承諾



@宜蘭縣 無尾港 生態復育 / 候鳥棲地保育 / 防風林植樹 / 社區創生共榮

@新北市 翡翠灣 海洋保育 / 海洋教育 / 企業親子淨灘活動



## 2025 永續亮點

- 公司治理評鑑維持 **6~20%** 等級
- 通過董事會核准淨零排放路徑目標，積極邁向淨零轉型的長程方向
- 成立「永續發展暨資安委員會」，強化公司在環境、社會、治理與資訊安全面向的整合管理與效率
- 榮獲國際 EcoVadis 銅級及天下永續公民獎、天下人才永續獎、親子天下友善家庭職場獎等多項殊榮，展現宜鼎在永續治理的全方位成果

## 2026 發展目標

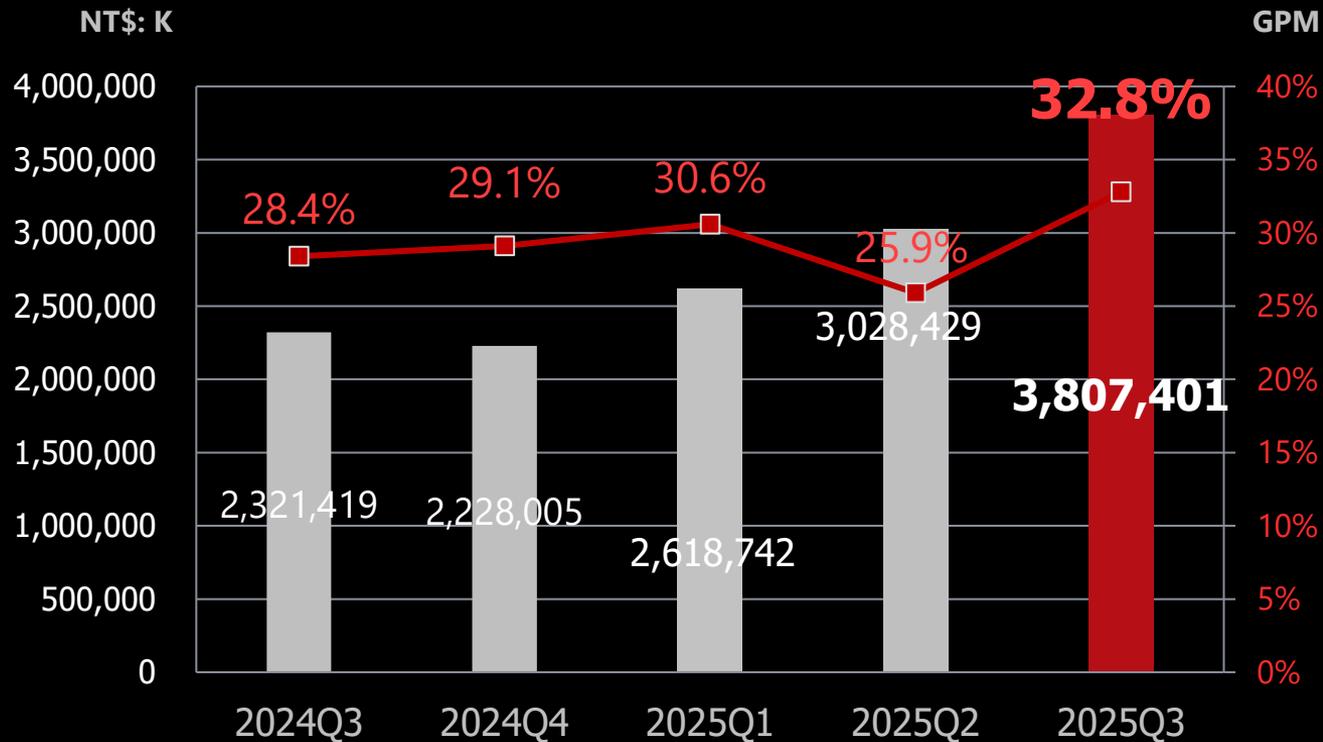
- 持續推進再生能源提升與能源管理導入，實現減碳行動成效
- 推動員工參與及社會共融計畫，深耕生物多樣性計畫以擴大永續影響力
- 完善永續治理架構與資訊揭露，強化與國際標準IFRS接軌



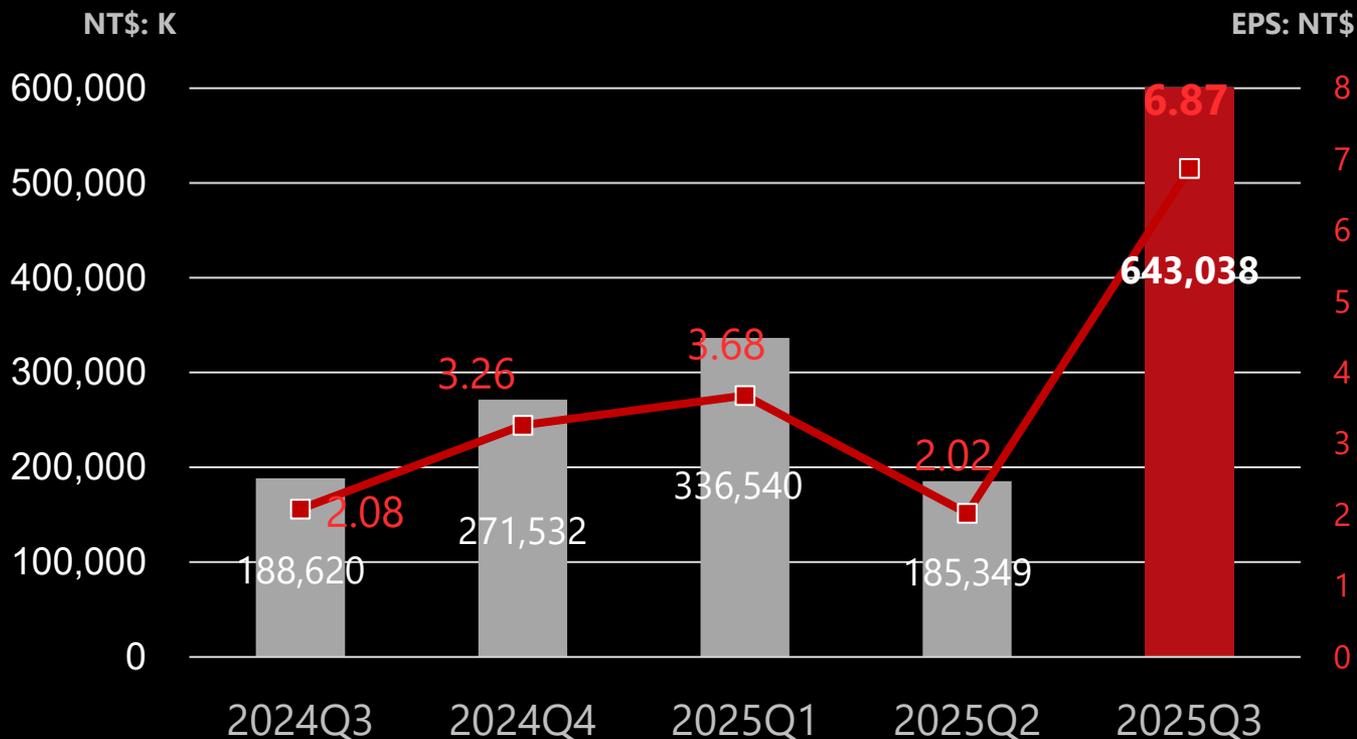
# 宜鼎國際 永續之路

# 財務資訊

## 過去 5 季營收與毛利率

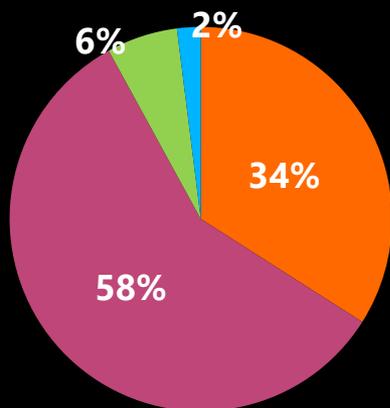


## 過去 5 季淨利與 EPS

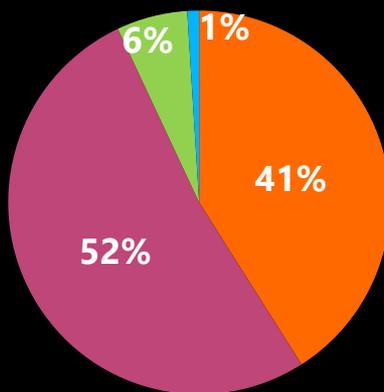


## 產品營收佔比變化

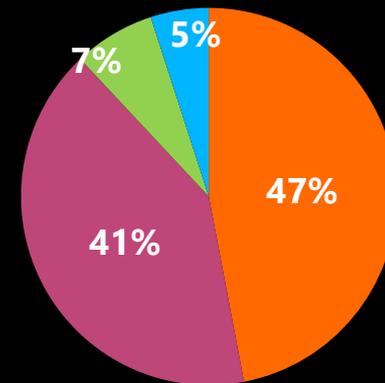
2025Q3



2025Q2



2024Q3



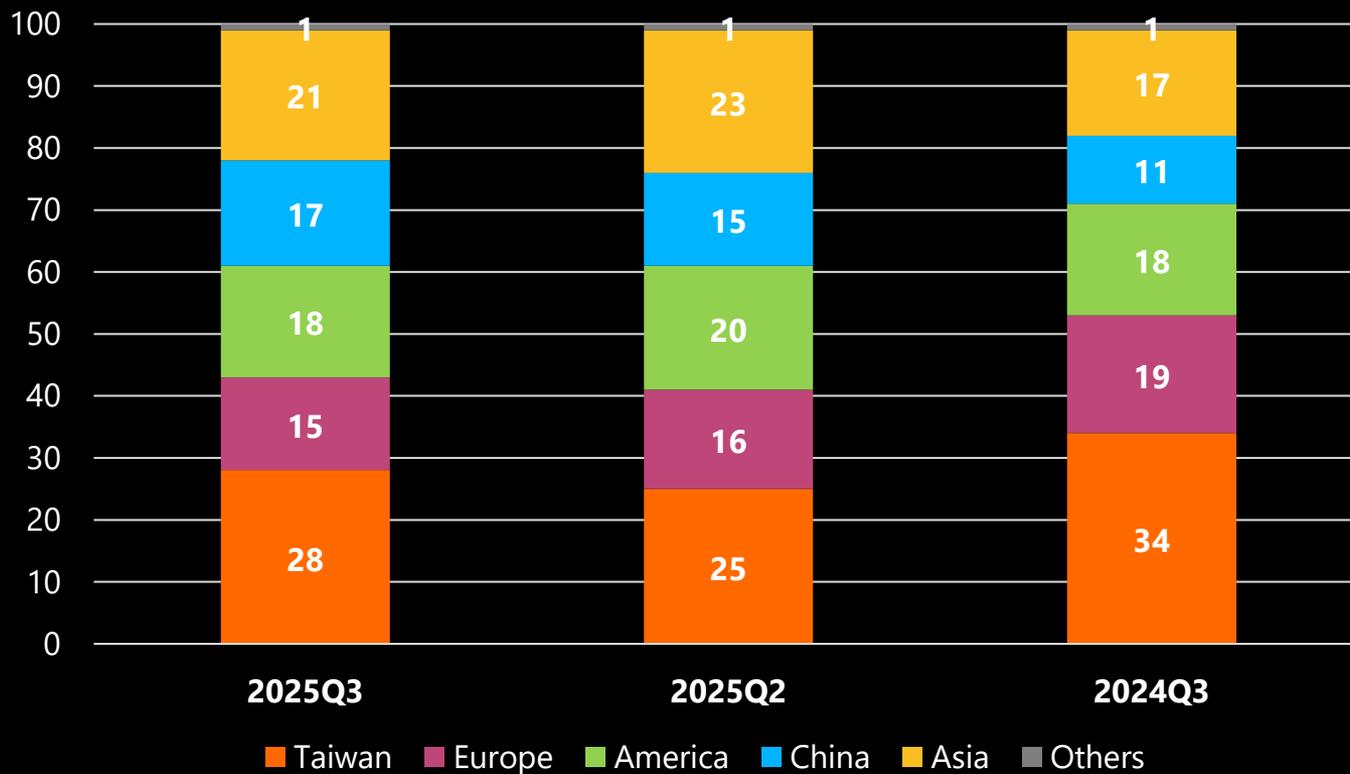
DRAM

Flash

AI Solutions

Others

## 營收依區佔比



## 2025Q3營運成果

	2025Q3	2025Q2	QoQ	2024Q3	YoY
營業收入	<b>3,807,401</b>	<b>3,028,429</b>	<b>25.7%</b>	<b>2,321,419</b>	<b>64.0%</b>
營業成本	2,558,583	2,243,340	14.1%	1,662,986	53.9%
營業毛利	<b>1,248,818</b>	<b>785,089</b>	<b>59.1%</b>	<b>658,433</b>	<b>89.7%</b>
營業費用	531,059	431,279	23.1%	413,237	28.5%
營業利益	<b>717,759</b>	<b>353,810</b>	<b>102.9%</b>	<b>245,196</b>	<b>192.7%</b>
營業外收入及支出	88,738	-126,311	-170.3%	-11,351	-881.8%
稅前淨利	<b>806,497</b>	<b>227,499</b>	<b>254.5%</b>	<b>233,845</b>	<b>244.9%</b>
所得稅費用	163,923	53,708	205.2%	48,618	237.2%
本期淨利	<b>642,574</b>	<b>173,791</b>	<b>269.7%</b>	<b>185,227</b>	<b>246.9%</b>
非控制權益利益	-464	-11,558	-96.0%	-3,393	-86.3%
歸屬母公司淨利	<b>643,038</b>	<b>185,349</b>	<b>246.9%</b>	<b>188,620</b>	<b>240.9%</b>
基本每股盈餘	<b>6.87</b>	<b>2.02</b>		<b>2.08</b>	
毛利率	32.8%	25.9%		28.4%	
營業利益率	18.9%	11.7%		10.6%	
淨利率	16.9%	5.7%		8.0%	

# 提問與說明

**innodisk**

**ARCHITECT  
INTELLIGENCE**